

Impel Plus バックプレーンコネクタ

molex®

Impel Plus バックプレーンコネクタシステムは、超小型のコンプライアントピンを使用し、優れた高周波デジタル信号特性を実現することで、最大56 Gbpsのデジタル信号伝送を達成しています。

特徴・利点

超小型のコンプライアントピンを使用した、最大56 Gbpsのデジタル信号伝送のバックプレーンコネクタ

多様なハイエンドアーキテクチャに対応し、上位・下位の互換性を備える

ドーターカード側に取り付けられたテールアライナーは、それぞれの信号用グランド端子とシールド用グランド端子を共通コモンに接続。これにより、グランドリターンパスの低インピーダンス化を実現

インピーダンスの不連続な変動を抑えることで、クロストーク特性を低減

高速デジタル信号特性に有利な接点構造を採用

接点構造を直列2接点から1点接点にすることで、挿入損失特性に見られる共振ポイントを30 GHz以上の帯域にシフト

超小型コンプライアントピン
(0.31mm ±0.05)

PCB配線の最適化とピンニングビアを追加することにより、クロストーク特性を低減

超小型のコンプライアントピンには、0.65mmのバックドリル加工を追加可能。高速デジタル信号をPCBの表層近くに配線することで、より優れた信号特性の実現を提案

PCBのスルーホールが浅くなることで、高速デジタル信号特性を改善

公称インピーダンス 90 Ω

インピーダンスの不連続な変動を最小化

結合度の高い差動ペア構造を使用した、モレックスのImpelコネクタテクノロジー (特許出願中)

コネクタシステムとして、優れた高速デジタル信号特性と機械特性を提供

IEEE 10GBASE-KR および Optical Internetworking Forum (OIF) Stat Eye Compliant Channel

エンドツーエンドのチャネルパフォーマンスが規格を満たしていることを証明済み



Impel Plus 3ペア、ライトアングル
ドーターカード、1.90mmピッチ

アプリケーション

通信 / ネットワーク関連機器

ハブ

サーバー

医療機器

患者監視装置

航空宇宙・防衛



ハイエンドサーバー

Impel Plus バックプレーンコネクタ

molex®

仕様

参考情報

梱包形態: トレイ
嵌合相手: Impelストレートバックプレーン
ヘッダー (171335シリーズ)
寸法単位: mm
RoHS: 準拠
ハロゲンフリー: 適合

電気的性能

最大定格電圧: 150V AC RMS
最大定格電流: 0.75A
接触抵抗: 100mA、20mV
耐電圧: 500V AC
絶縁抵抗: 500V

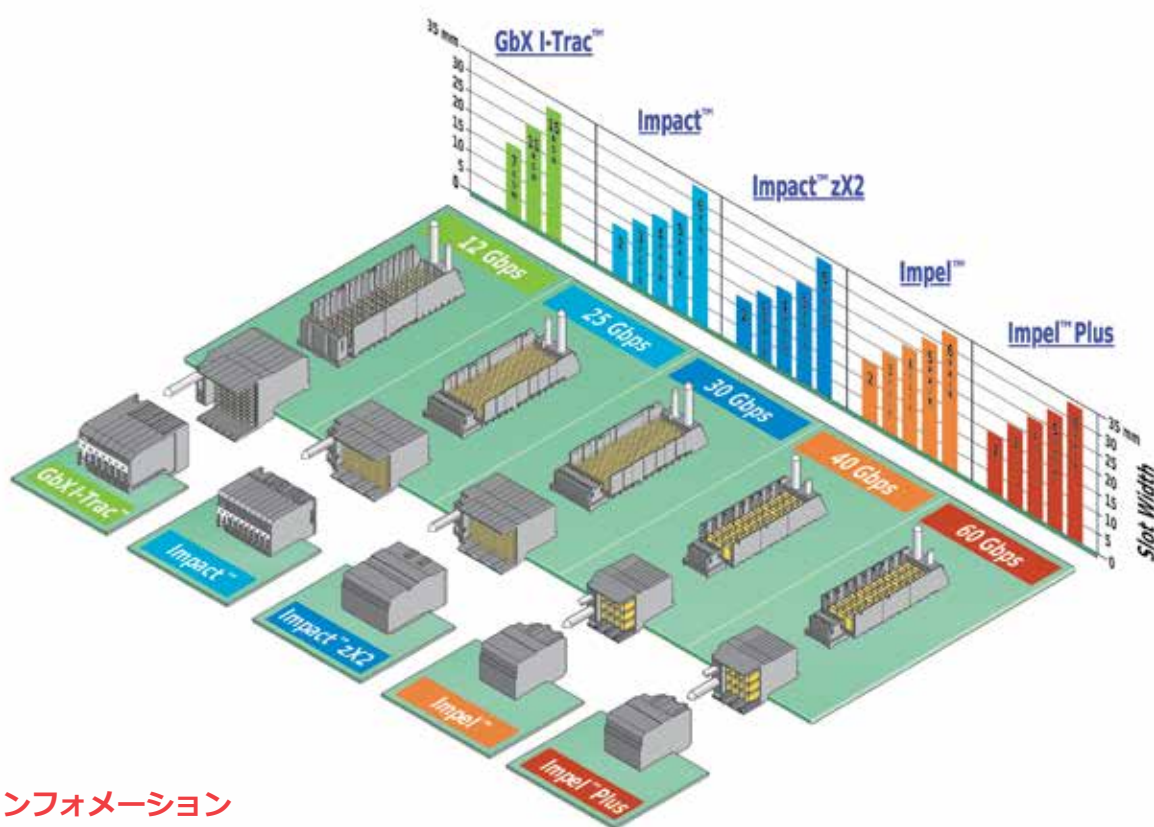
機械的性能

対基板挿入力: 26.69N以下 (テール当たり)
嵌合力: 60g (信号ピン)、80g (シールド)
抜去力: 15g以上
耐久挿抜回数: 200回以上

材質

ハウジング: LCP
コンタクト: 銅合金
メッキ:
コンタクトエリア: 0.76μm 金
半田付け部: 部分無光沢錫
下地メッキ: ニッケル
基板厚: 1.00mm
使用温度範囲: -40 ~ +105°C

バックプレーン基板対基板製品



オーダーインフォメーション

シリーズ番号	コンポーネント	ピッチ	差動ペア数
172730	ドーターカード	1.90mm	3

www.molex.com/link/impel.html
www.japanese.molex.com/link/impel.html

Molexは、アメリカ合衆国におけるMolex, LLCの登録商標であり、他の国々でも登録されている場合があります。ここに表示されているその他すべての商標も該当する所有者に帰属します。